



TS-TIR®700-09系列 是一款高效碳纤维导热垫片，结合高导热碳纤维与高分子硅胶材料，以先进工艺精准分布导热通路，实现优异的热传导性能，有效降低界面热阻并提升散热效率。其具备超薄轻量 and 机械柔韧性，适用于5G设备、高性能芯片及其他高热通量应用。

特性

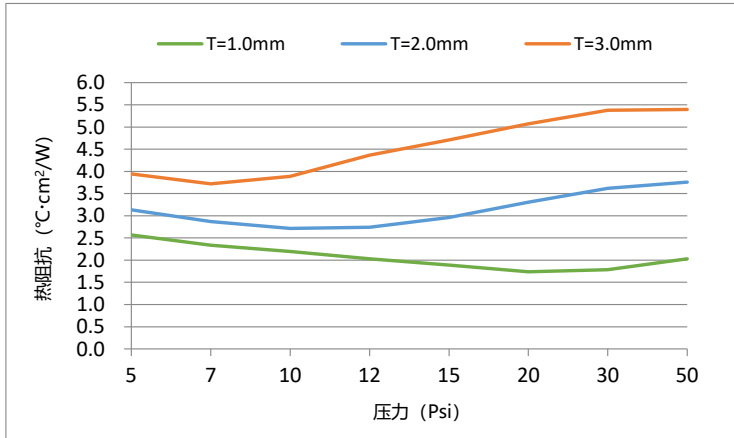
- 》良好的热传导率 9 W/mK
- 》极低热阻抗
- 》可在低压下工作
- 》非绝缘型材料
- 》无表面粘性

应用

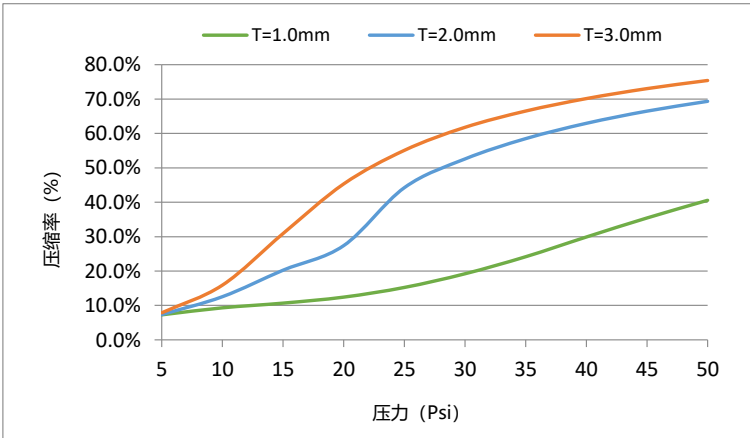
- 》芯片与散热模组之间
- 》5G通讯设备
- 》光电行业
- 》可穿戴设备

TS-TIR® 700-09 系列碳基导热垫系列特性表		
产品特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	目视
结构&成份	碳纤维填充硅橡胶	-
厚度范围	0.04" ~0.20" (1.0~5.0mm)	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	55±10	ASTM D2240
密度 (g/cc)	2.1	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40~200	兆科测试
导热系数 (W/mK)	9.0	ASTM D5470
比热容 (J/g·°C)	0.93	ASTM E1269 @25°C
阻燃等级	V-0	等同于UL94
RoHS	符合	IEC62321

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.04" (1.0 mm), 0.06" (1.5 mm), 0.08" (2.0 mm), 0.10" (2.5 mm), 0.12" (3.0 mm)
标准尺寸: 1.97" × 1.97" (50.0 mm × 50.0 mm)

TS-TIR®700-09 系列产品可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。如需更大尺寸，请与本公司联系。
欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。

